

广东生益科技股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司从事的主要业务为：设计和销售覆铜板和粘结片。公司立足于终端功能需求的解决者，始终坚持高标准、高品质、高性能，高可靠性，自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于高算力、AI 服务器、5G 天线、新一代通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。

公司围绕“以客户为中心，以价值为导向”的理念，持续夯实提升内部管理，生产部门持续提升制造过程能力，深入推进精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，为更精益的生产管理和更稳定的产品品质提供了强有力的支持。公司紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划。公司自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，并获得各行业领先制造商的高度认可。

对于电子行业而言，2026 年将延续 AI 驱动的增长周期，但其驱动逻辑正从以训练为核心的大规模算力扩张，逐步转向更为广泛的推理应用落地。AI 服务器需求持续释放，正推动整个产业向高阶化演进，印刷电路板领域也因此迎来结构性利好，预计 2026 年全球 PCB 产值将增长 12.5%至 957.8 亿美元，其中 18 层以上多层板、HDI 板和封装基板将成为主要增长点，高端化趋势进一步加深。2026 年不仅是“十五五”开局之年，更是电子行业增长范式从“AI 驱动”迈向“AI+应用”深度融合的关键转折之年，机遇与挑战并存。

公司将坚持以做强做大覆铜板为主业的战略，坚持在覆铜板行业成为全球最具综合竞争优势的制造商，将持续加大对新技术研发，新产品研究的投入，以前瞻性的产品布局匹配高

端市场的发展需求。继续保持对市场的敏锐反应，始终以前瞻的眼光、先进的技术水平和创新的精神适应不断变化的市场，并及时提供满足客户要求的产品和服务，持续为客户创造更大价值。

二、坚持共享成果，积极回报投资者

公司秉承“股东、员工、社会”三共享原则，高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

公司自 1998 年上市至今 28 年来坚持连续每年实施现金分红，现累计分配现金红利超 129 亿元（含税），但公司通过 IPO、非公开发行及发行可转债，共募集资金净额为 33.55 亿元，现金分配总额是募集资金净额的 3.8 倍。2023 及 2024 年，公司含税现金分红数额占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别是 91.41%、83.84%，预计 2025 年度含税现金分红数额占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率约 87%（包含已在 2025 年 9 月实施的 2025 年半年度分红，及预计实施的 2025 年度利润分配预案，此预案需经股东会审议通过）。

公司将继续坚持三共享原则，根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平，增强投资者获得感。

三、持续加强研发投入，发展新质生产力

公司于 2011 年获得国家发改委认定的“国家认定企业技术中心”，同年获国家科技部批准组建了“国家电子电路基材工程技术研究中心”，是行业唯一的国家级工程技术研究中心，中心愿景是成为世界先进水平的电子电路基材研发工程化平台、中国高端电子电路基材技术标准的主导者。针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品。公司经过持续二十余年的技术研发，已沉淀了深厚的技术积累，公司可以配合到用户的各种需求，及时推出满足客户需求的一代代产品。公司自主研发的多系列新品参与市场竞争，大力开展自主创新，努力摆脱国外的技术和专利限制，大大缩短我国在该技术领域与世界先进水平的差距。

公司将充分利用在产品研发上的深厚经验及知识产权积累，重点聚焦高算力、AI 服务器、航空航天、芯片封装等领域的相关技术研发，丰富产品品类，进一步扩大竞争优势。公

公司将通过高效的技术开发、产品技术创新，持续为客户创造价值，利用公司产品研发的技术沉淀，优化公司竞争格局，推进公司稳步持续增长。

四、加强投资者沟通，高效传递价值

公司通过股东会、投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者接待活动、设立公司网站投资者关系专栏等多种形式与投资者进行全面深入的沟通，及时回应投资者关注的问题，增进彼此的了解和信任，建立了更加稳定、健康的投资者关系，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

公司将继续严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。公司将形成常态化召开业绩说明会工作机制，2026 年将召开 3 次业绩说明会，同时，积极参加广东上市公司协会、广东证监局等组织的集体路演、投资者交流等活动。在与投资者沟通交流过程中，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

五、坚持规范运作，提升治理水平

公司于 1998 年在上海证券交易所上市，上市二十余载，始终坚持稳健经营策略，合法合规运行，从完善制度体系、优化公司治理结构、强化信息披露制度等维度，不断提升整体规范化运作水平，充分展现了上市公司的责任担当，为公司高质量稳健发展提供了强有力的支撑。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理结构，股东会、董事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

公司一直坚持现代企业制度的治理模式运作，建立了健全的公司法人治理结构、规范有效的内部控制体系，组建了稳定的管理团队和核心技术团队，保证了公司 30 多年的持续稳定发展。公司将坚持不断完善法人治理结构，践行“所有权与经营权分离”的现代企业制度核心理念。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，建立并完

善相关制度，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、广东证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

公司将持续强化“关键少数”责任，加强董事和高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日